



佛山市香港科技大学LED-FPD工程技术研究开发中心  
HKUST LED-FPD Technology R&D Center at Foshan

第 20 届广州国际照明展览会

20<sup>th</sup> Guangzhou International Lighting Exhibition

佛山市香港科技大学 LED-FPD 工程技术研究开发中心

HKUST LED-FPD Technology R&D Center at Foshan

## LED 技术论坛 暨 合作协议签署仪式

(LED Technical Forum)

时间：2015 年 06 月 09 日，星期二，下午 2:00-5:00

地点：中国进出口商品交易会展馆，广州琶洲展馆 9.1 馆 E15

论坛主题：**LED 封装的四大元素——有关光、电、热、机的那些事儿**

论坛主持人：李世玮 教授，佛山市香港科技大学 LED - FPD 工程技术研究开发中心主任

演讲嘉宾及预定议程：

14:00 - 14:30 开场简介与综述

李世玮 教授，佛山市香港科技大学 LED - FPD 工程技术研究开发中心主任

14:30 - 15:00 混粉白光 LED 光谱计算方法

卢智铨 博士，香港科技大学先进微系统封装中心电子封装实验室项目经理

15:00 - 15:30 用于智能 LED 的可见光通信系统芯片

吴亮 博士，香港科技大学电子及计算机工程学系研究助理教授

15:30 - 16:00 以延缓 LED 光衰为目标的产品热设计优化方法

姜燕清 经理，北京海基科技发展有限公司

16:00 - 16:30 先进倒扣芯片互连技术

李 明 博士，ASM 研发部资深技术经理

16:30 - 16:40 港科大工程技术研究开发中心与北京海基科技公司合作协议签署仪式

16:40 - 17:00 座谈讨论（讨论完毕后进行抽奖）

主办单位：佛山市香港科技大学 LED-FPD 工程技术研究开发中心

协办单位：北京海基科技发展有限公司

地 址：佛山市南海区桂城深海路 17 号瀚天科技城 A 区 7 号楼 304 单元  
Address: Unit 304, Bldg. 7, Block A, Hantian Ind. Park, Foshan, Guangdong, China.

网址：www.fslldctr.org  
Fax: +86-757-86081835

## 讲师简介

	<p>李世玮 教授，香港科技大学机械工程系教授，兼任科大先进微系统封装中心主任及佛山市香港科技大学 LED - FPD 工程技术研究开发中心主任。李教授的研究领域覆盖晶圆级和三维微系统封装、硅通孔和高密度互连、以及 LED 封装和半导体照明技术。李教授现任 IEEE CPMT 学会总裁，并于 1999、2003、2008 和 2013 年分别被英国物理学会(IoP)、美国机械工程师学会 (ASME) 、IEEE 和 IMAPS 评选为学会院士。</p>
	<p>卢智铨 博士，香港科技大学先进微系统封装中心电子封装实验室项目经理，2002 年获得香港科技大学机械工程系一级荣誉学士学位。随后分别于 2004 年及 2008 年获得香港科技大学机械工程系硕士及博士学位。自 2004 年起在香港科技大学先进微系统封装中心电子封装实验室工作。现时，担任该实验室项目经理一职，负责技术培训和人员管理，亦会与工业界合作研发并替工业界作可靠性测试和分析。卢博士主要的研究方向为倒焊芯片组装、晶圆级封装、芯片级封装、LED 封装及测试、微系统封装，以及可靠性测试和分析。</p>
	<p>吴亮 博士，香港科技大学电子及计算机工程学系研究助理教授，吴亮博士分别于 2004 年和 2007 在复旦大学材料科学系获得学士学位和硕士学位，并于 2012 年在香港科技大学电子及计算机工程学系获得博士学位。2013 年 3 月起加入香港科技大学电子及计算机工程学系，现任研究助理教授兼港科大—高通联合创新及研究实验室副主任。他的研究方向主要包括用于低功耗无线收发机的射频/毫米波 CMOS 集成电路芯片，可见光通信系统级芯片等。</p>
	<p>姜燕清 毕业于江苏南京东南大学，获工学硕士学位。长期从事 CAE 流程 应用及体系开发工作。2006 年至 2010 年在特灵 (TRANE) 上海研发中心负责 空调 FEA 技术工作。2010 年至 2014 年任格力电器商用空调技术部 CAE 主管，负责商用空调 CAE 流程、体系开发，公司技术专家。2015 年加盟海基科技，现任海基科技华南大区经理、战略产品专家，负责行业 CAE 解决方案开发、战略产品优化及华南市场运营。</p>
	<p>李 明 博士，拥有超过 20 年在材料结构和性能，以及电子封装与测试领域的工作经验。曾在英国伦敦大学材料科学系进行博士后的研究，在新加坡国家材料研究所负责电子封装团队的研究工作，在香港的中文大学教课及进行光电子封装的研究。李博士于 2004 年 6 月加入 ASM，现任研发部资深技术经理。主要负责改良现有的封装工艺及开发新型的封装技术。主要研究和开发的课题有发光二极管封装，铜线键合，倒装焊等电子/光电子封装技术。李博士曾任电机及电子工程师学会的电子组件封装制造技术学会香港分会主席，并为多本电子封装学术期刊和国际学术会议审稿。</p>

活动详情请联系：潘小姐 0757 - 86081832 Email: [pansy@fslldctr.org](mailto:pansy@fslldctr.org)